2020年2月5日

**Samtec的 Istvan Novak 获 DesignCon 2020 年度工程师奖**

加利福尼亚州圣克拉拉：Samtec, Inc., 的首席讯号和电源完整性工程师Istvan Novak日前于北美最大的芯片、电路板和系统展会DesignCon上被授予DesignCon 2020年度工程师奖 (DesignCon 2020’s Engineer of the Year)。

Novak发表了业界第一个用于大型刚性计算器板的25 µm电源接地层压板，并与零组件供货商合作创建了一系列低电感和可控等效串联电阻旁路电容器。

Novak 表示：「由全球顶尖的专家Jay Diepenbrock、Vladimir Dmitiev-Zdorov、Tim Hollis、Michael Schnecker和Yuriy Shiepnev选为“ DesignCon 2020年度工程师”使我感到非常振奋和荣幸。 对我自己和我的许多同事来说，DesignCon多年来一直是必参加的会议，其年复一年提供最高等级的灵感、知识和机会。」

DesignCon活动举行期间，每年都会颁发DesignCon年度工程师奖。 该奖项旨在表彰在芯片、电路板或系统级之工程和新产品开发之佼佼者。

优胜者获选主要是基于针对芯片设计/测试、电路板或系统设计的领导力，创造力，以及对其打破常规能力的认可，尤其是对于讯号和电源完整性领域。

相关奖项是于1月30日(星期四)在圣克拉拉会议中心剧院的DesignCon上宣布。 得奖者并获得$ 1,000美元的奖励，或根据其选择用于对教育机构之赞助或奖学金。

关于DesignCon年度工程师奖之更多信息请参考链接:

<https://designcon.com/engineer-year-award>

关于 Samtec, Inc.

Samtec成立于1976年，是一家营收达8亿美元之多样化电子互连方案的私人控股全球制造商，产品涵盖高速板对板、高速电缆、中板和面板光学、精准RF、柔性堆栈和微型/坚固的零组件和电缆。透过由40个据点服务近125个国家，Samtec的全球能见度使其能提供无与伦比的客户服务。更多信息请参阅<http://www.samtec.com>

更多信息请联系:

Danny Boesing

产品营销总监

danny.boesing@samtec.com